

Nome:

ENGENHARIA DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA TELECOMUNICAÇÕES

Créditos Aula: 4 crs. (64 h.)

Ementa/Descrição:

Introdução. Ciência do Estado Sólido, Processamento Cerâmico, Cerâmicas Condutoras, Dielétricos e Isolantes, Cerâmicas Piezoelétricas, Materiais Piroelétricos, Cerâmicas Eletro-ópticas, cerâmicas magnéticas, ligas metálicas, polímeros

Referências:

- M.T. Sebastian, Dielectric Materials for Wireless Communication, Elsevier, 2008.
- L.F. Chen, C.K. Ong, C.P. Neo, V.V. Varadan, V.K. Varadan, Microwave Electronics, John Wiley & Sons, 2004.
- R.C. Buchanan, Ceramic Materials for Electronics, Marcel Dekker, 2004.
- A.J. Moulson, J.M. Herbert, Electroceramics, Wiley, 2003.
- W.D. Callister, Materials Science and Engineering: An Introduction, 4th ed., Wiley, 1997.
- K.K. Chawla, Ceramic Matrix Composites, 2nd ed., Kluwer Academic Publishers, 2003.
- M. Bengisu, Engineering Ceramics, Springer, 2001.